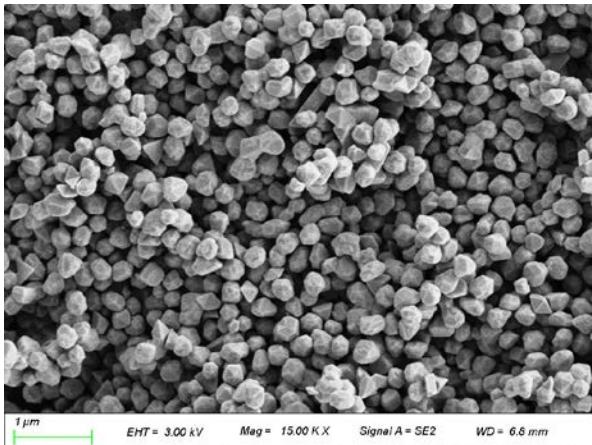
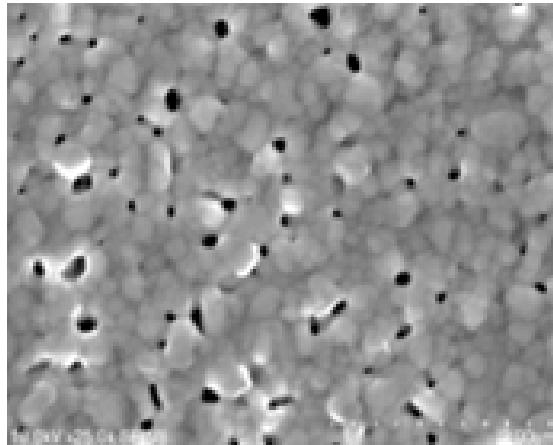


多面体银粉



SEM

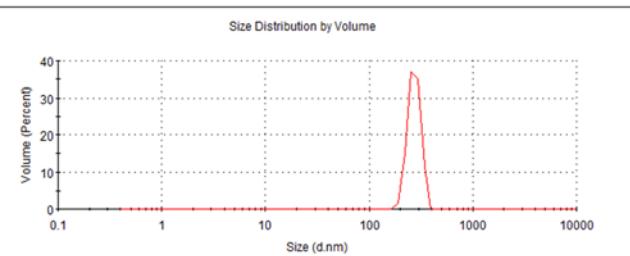


烧结

Z-Average (d.nm): 1829
Pdt: 1.000
Intercept: 0.768

Size (d.nm):	% Volume:	St Dev (d.nm):
Peak 1: 272.8	100.0	36.93 D10.nm: 229
Peak 2: 0.000	0.0	D50.nm: 271
Peak 3: 0.000	0.0	D90.nm: 321

Result quality : Refer to quality report



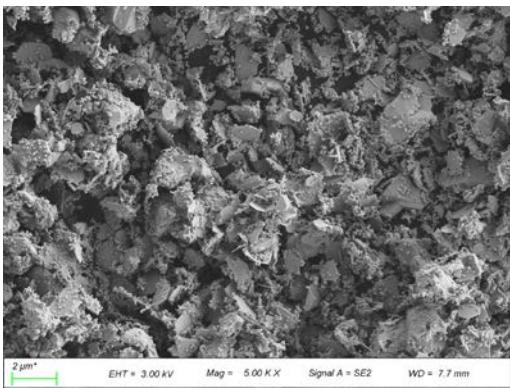
粒度分布

特性	
粒子形状	多面体
粒子大小 (nm)	150 ~ 350
比表面子 (m^2/g)	1.2 ~ 2.2
振实密度 (g/cm^3)	4.5 ~ 5.5

高比表面积、高结晶度、良好的粒度分布和面与面交界以及尖角纳米效应由来的高表面活性使其在导电材料、催化剂、抗菌涂层以及光学材料等领域具有显著优势。这种形貌和结构特性使其优于传统的球形或片状银粉，在高端应用中表现更加突出。

多面体银粉作为高性能导电填料，适用于电子浆料、导电涂料、电磁屏蔽材料、导电油墨、导电塑料和陶瓷等领域。随着微电子、柔性电路和纳米材料需求的增长，该技术可提升器件电性能和可靠性，推动智能穿戴、物联网和新能源产业的发展，前景乐观。

片银+粒银



特性	
粒子形状	多面体+球银
片银厚薄 (nm)	<100
粒银径 (nm)	<50
比表面子 (m^2/g)	0.5 ~ 1.5
振实密度 (g/cm^3)	3.0 ~ 3.5

SEM

液相还原工艺原位生成的片粒状比例可调的银粉，即改善了片状银粉的流动性，又提高了粒状银粉的导电性，优化了低温烧结性能，适合多种电子应用需求。

该银粉适用于电子工业导电材料领域，如电子银浆、触控屏、薄膜开关、太阳能电池电极等。随着5G、柔性电子和光伏产业的快速发展，该技术可显著提升浆料导电性和可靠性，推动高性能电子元器件的大规模应用，市场前景广阔。

低温烧结电性能

